

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2024년 11월 28일 (28.11.2024)



(10) 국제공개번호

WO 2024/242253 A1



(51) 국제특허분류:

G01R 31/28 (2006.01)

G01K 1/024 (2021.01)

G01R 1/04 (2006.01)

G01K 1/14 (2006.01)

H05B 3/20 (2006.01)

(21) 국제출원번호:

PCT/KR2023/018300

(22) 국제출원일:

2023년 11월 14일 (14.11.2023)

(25) 출원언어:

한국어

(26) 공개언어:

한국어

(30) 우선권정보:

10-2023-0066459 2023년 5월 23일 (23.05.2023) KR

(71) 출원인: 주식회사 티에프이 (TFE CO., LTD.) [KR/KR];
18384 경기도 화성시 반월길 50-8, Gyeonggi-do (KR).

(72) 발명자: 문성주 (MOON, Sung Jue); 18384 경기도 화성시 반월길 50-8, Gyeonggi-do (KR).

(74) 대리인: 특허법인 태하 (JYK IP LAW FIRM); 16712 경기도 수원시 영통구 봉영로 1767, 501호(영통동, 한솔프라자), Gyeonggi-do (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

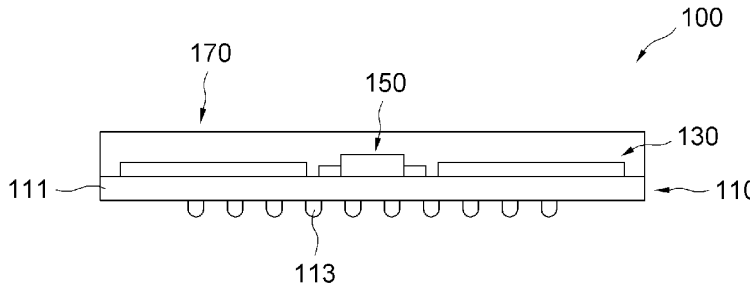
(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: SEMICONDUCTOR PACKAGE HEAT GENERATION SIMULATION UNIT FOR CHECKING HEAT DISTRIBUTION OF BURN-IN BOARD, AND METHOD FOR OBTAINING HEAT DISTRIBUTION OF BURN-IN BOARD BY USING SAME

(54) 발명의 명칭: 번인 보드의 열 분포를 확인하기 위한 반도체 패키지 발열 모사 유닛 및 그를 이용한 번인 보드의 열 분포 획득 방법



(57) Abstract: The present invention provides a semiconductor package heat generation simulation unit for checking heat distribution of a burn-in board, and a method for obtaining heat distribution of a burn-in board by using same, wherein the semiconductor package heat generation simulation unit for checking heat distribution of a burn-in board comprises: a circuit board having an input/output terminal corresponding to a conductive portion of a socket of a burn-in board, and a power terminal and a signal terminal connected to the input/output terminal; a heater configured to generate heat by power inputted through the power terminal; and a temperature sensor configured to measure a temperature according to the heat generation of the heater and output temperature information about the temperature through the signal terminal.

(57) 요약서: 본 발명은, 번인 보드의 소켓의 도전부에 대응하는 입출력 단자와, 상기 입출력 단자와 연결되는 전원 단자 및 신호 단자를 구비하는 회로기판; 상기 전원 단자를 통해 입력되는 전원에 의해 발열하도록 형성되는 히터; 및 상기 히터의 발열에 따른 온도를 측정하여, 상기 신호 단자를 통해 상기 온도에 관한 온도 정보를 출력하도록 형성되는 온도 센서를 포함하는, 번인 보드의 열 분포를 확인하기 위한 반도체 패키지 발열 모사 유닛 및 그를 이용한 번인 보드의 열 분포 획득 방법을 제공한다.



WO 2024/242253 A1